



第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

演讲题目: 智算中心光互连技术趋势

演讲人:张源 专家级讲师

演讲人简介:

1999年北航材料学硕士毕业后,入职华为,一直从事先进材料及工艺的创新研究。2000~2011年,曾做为首任 leader 带领创建 PCB、SiP 封装工艺技术业务及团队,并曾任电子材料研发团队的技术首席,开发过多项行业领先技术;期间曾任 IPC 协会 7-31bCN 中国区委员会首任主席,组织 610CN 等标准开发。2011~2020年曾任 网络及光电板级工程领域的首席规划师,规划并参加开发多款领先全球的关键部件及技术。2020年离开华为至今,出于对行业的热爱,持续板级和封装工程领域的探索,做为个人讲师为行业服务。